



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203279916 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320293216. 2

(22) 申请日 2013. 05. 24

(73) 专利权人 张晓平

地址 314512 浙江省嘉兴市桐乡市石门镇邵
墩创业园桐乡市金辉鞋材有限公司

(72) 发明人 张晓平

(74) 专利代理机构 宁波市鄞州金源通汇专利事
务所(普通合伙) 33236

代理人 唐迅

(51) Int. Cl.

A43B 13/32(2006. 01)

A43B 13/14(2006. 01)

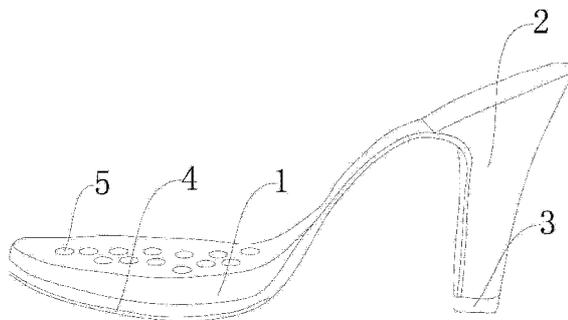
权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

高跟鞋底

(57) 摘要

本实用新型所设计的一种高跟鞋底,它主要由鞋底本体与鞋跟组成,鞋底本体后端向下弯折与鞋跟正面通过胶水粘接,鞋底本体弯折部分的最下端与鞋跟的最下端齐平,在鞋跟底部设有耐磨橡胶垫,在鞋底本体的前端底部设有耐磨层,在鞋底本体正面设有若干圆柱形凹孔。这种高跟鞋底,其将鞋底本体的后端向下折弯与鞋跟的正面粘接,接触面积大,使两者连接更加牢固,避免了脱胶等现象的发生,提高鞋子的使用寿命,而且制成皮鞋后,使其外观的整体性更好。另外,在鞋底本体正面凹孔的设置,可降低鞋底的重量,提高其穿着的舒适性。



1. 一种高跟鞋底,它主要由鞋底本体与鞋跟组成,其特征是鞋底本体后端向下弯折与鞋跟正面通过胶水粘接,鞋底本体弯折部分的最下端与鞋跟的最下端齐平,在鞋跟底部设有耐磨橡胶垫,在鞋底本体的前端底部设有耐磨层。

2. 根据权利要求 1 所述的高跟鞋底,其特征是在鞋底本体正面设有若干圆柱形凹孔。

高跟鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及皮鞋制造领域,尤其是一种高跟鞋底。

背景技术

[0002] 现有的女式高跟皮鞋的鞋底,其鞋底本体采用胶水与鞋跟的顶部粘接,且粘接处的鞋跟本体的厚度较薄,粘接面积较小,造成其牢固性能较差,在长时间使用后,容易出现断裂、脱胶等现象,影响鞋子的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于了解决上述技术的不足而提供一种连接牢固,穿着舒适的高跟鞋底。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型所设计的高跟鞋底,它主要由鞋底本体与鞋跟组成,鞋底本体后端向下弯折与鞋跟正面通过胶水粘接,鞋底本体弯折部分的最下端与鞋跟的最下端齐平,在鞋跟底部设有耐磨橡胶垫,在鞋底本体的前端底部设有耐磨层。

[0005] 作为优化,在鞋底本体正面设有若干圆柱形凹孔。

[0006] 本实用新型所得到的高跟鞋底,其将鞋底本体的后端向下折弯与鞋跟的正面粘接,接触面积大,使两者连接更加牢固,避免了脱胶等现象的发生,提高鞋子的使用寿命,而且制成皮鞋后,使其外观的整体性更好。另外,在鞋底本体正面凹孔的设置,可降低鞋底的重量,提高其穿着的舒适性。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 实施例 1:

[0010] 如图 1 所示,本实施例描述的高跟鞋底,它主要由鞋底本体 1 与鞋跟 2 组成,鞋底本体 1 后端向下弯折与鞋跟 2 正面通过胶水粘接,鞋底本体 1 弯折部分的最下端与鞋跟 2 的最下端齐平,在鞋跟 2 底部设有耐磨橡胶垫 3,在鞋底本体 1 的前端底部设有耐磨层 4。

[0011] 在鞋底本体 1 正面设有若干圆柱形凹孔 5。

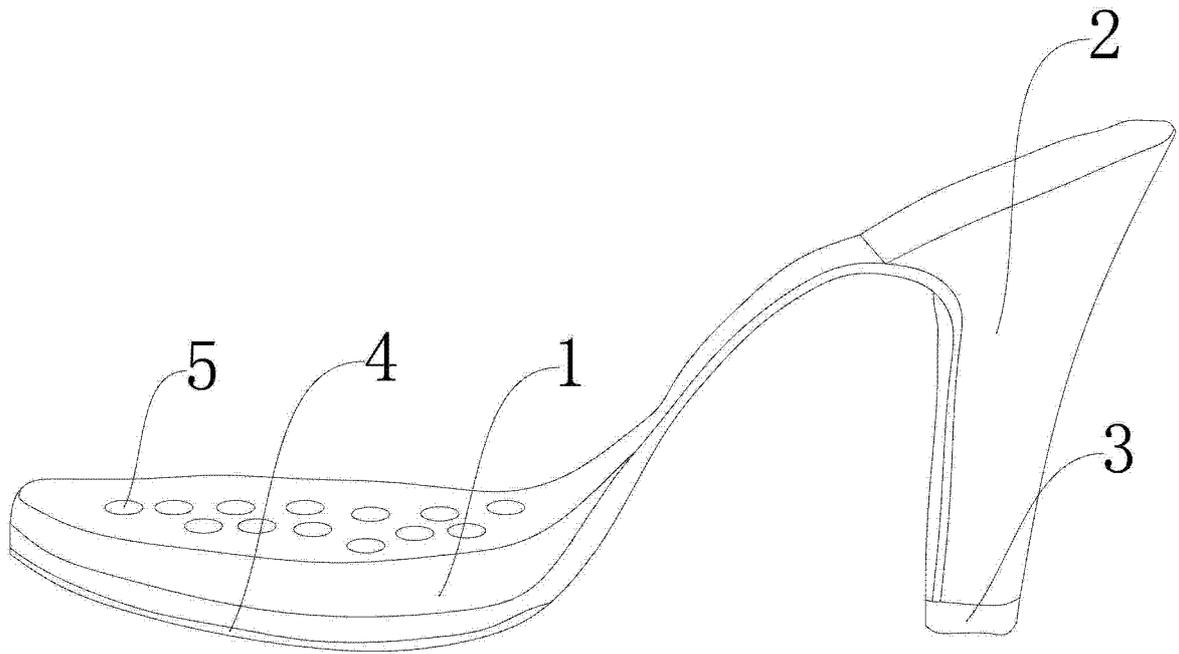


图 1